

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路製造有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00981)

海外監管公告

本公告乃中芯國際集成電路製造有限公司（Semiconductor Manufacturing International Corporation, 「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《關於2024年度利潤分配方案的公告》，僅供參閱。

承董事會命

中芯國際集成電路製造有限公司

公司秘書 / 董事會秘書

郭光莉

中國上海，2025年3月27日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

劉訓峰

非執行董事

魯國慶

陳山枝

楊魯閩

黃登山

獨立非執行董事

范仁達

劉明

吳漢明

陳信元

* 僅供識別

A股代码：688981

A股简称：中芯国际

公告编号：2025-005

港股代码：00981

港股简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 鉴于公司 2025 年仍将维持较大规模的资本支出，为保障公司正常生产经营和未来发展需要，公司 2024 年度不进行利润分配（包括不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本及其他形式的分配）。

● 本次利润分配方案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司 2025 年股东周年大会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据《开曼群岛公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）和中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“公司”）现行《经修订及重述组织章程大纲及细则》《利润分配政策》等规定，经董事会决议，公司 2024 年度不进行利润分配（包括不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本及其他形式的分配）。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年股东周年大会审议。

（二）是否可能触及 A 股其他风险警示情形

公司不触及 A 股其他风险警示情形，具体说明如下：

单位：人民币千元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额	-	-	-
回购注销总额	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润	3,698,665	4,822,814	12,133,079
母公司报表本年度末累计未分配利润	44,377,619		
最近三个会计年度累计现金分红总额	-		
最近三个会计年度累计回购注销总额	-		
最近三个会计年度平均净利润	6,884,853		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	-		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 3000 万元	是		
现金分红比例 (%)	-		
现金分红比例是否低于 30%	是		
最近三个会计年度累计研发投入金额	15,391,699		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入	152,562,079		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例 (%)	10.1		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在 15% 以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第 (八) 项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、2024 年度拟不进行现金分红的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 369,866.5 万元，拟不进行利润分配，具体原因说明如下。

(一) 公司所处行业及其特点、发展阶段、自身经营模式及资金需求

1、所处行业及其特点

公司所属晶圆代工行业为半导体产业链前端的关键行业，具备高度的技术密集、人才密集和资金密集的特点。晶圆代工的运营过程对生产环境、能源、原材料、设备和质量体系等有非常严格的管理和执行规范，其研发和制造过程涉及材料学、化学、半导体物理、光学、微电子、量子力学等诸多学科，立足

专业的技术团队与强大的研发能力，以及对工艺进行整合集成的工程能力，行业的技术门槛极高。

2、公司发展阶段及经营模式

当前，公司正处于推进产能建设、不断提升市场占有率的重要发展阶段，公司通过专注本业增强公司自身的核心竞争力和长期价值，确保公司在激烈的市场和竞争、不断变化的外部环境下，保持领先地位，为客户及股东创造价值。

3、资金需求

公司预计 2025 年度公司仍将维持较大规模的资本支出，预计超过公司最近一期经审计净资产的 30%，资金需求较高，公司需预留足够资金来满足产能扩充、发展公司核心业务，充分保障公司平稳运营、健康发展。

（二）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司 2024 年度未分配利润将累计滚存至下一年度，拟用于产能扩充、发展公司核心业务，通过进一步提升产能规模和技术水平，增强行业竞争力，从而实现净资产的稳步增厚和公司价值的不断增长，最大限度维护股东利益。

（三）中小股东参与利润分配决策的便利条件

公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线及邮箱等多种方式来表达对利润分配的意见和诉求。

同时，公司将于 2025 年股东周年大会提交审议《2024 年度利润分配方案》，并将采用现场与网络投票相结合的表决方式，为中小股东参与决策提供便利，充分保障了公司股东尤其是中小股东享有平等权益。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

为进一步增强投资者回报水平，公司自 2024 年起制定了“提质增效重回报”行动方案，在经营管理、研发创新、公司治理及投资者关系等方面采取积极措施，以进一步提高公司质量，保障投资者权益，促进公司健康可持续发展。

三、公司履行的决策程序

公司 2025 年 3 月 27 日董事会书面决议通过了《2024 年度利润分配方案》，并同意提交至公司 2025 年股东周年大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年股东周年大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日